

臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 科技龍頭通訊指數

壹、前言

臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 科技龍頭通訊指數 (簡稱「臺灣科技龍頭通訊指數」)係運用 FactSet 的 RBICS 產業分類，篩選通訊科技產業鏈中符合流動性標準及獲利條件之自由流通市值前 30 大個股，採用自由流通市值加權方法計算指數，表彰通訊科技產業鏈中臺灣上市上櫃龍頭股票組合之投資績效表現。

貳、計算與管理

- 一、臺灣科技龍頭通訊指數分「價格指數」(Price Index)、「報酬指數」(Total Return Index)，由臺灣指數公司負責編製，委請臺灣證券交易所計算及即時資訊傳輸。
- 二、臺灣指數公司依指數編製規則進行成分股定期審核。
- 三、臺灣指數公司將保存所有成分股的收盤市值紀錄。
- 四、指數編製、維護及管理原則，參閱「[臺灣指數公司有價證券指數通則](#)」。

參、成分股的選股原則

一、採樣母體：

1. 指數母體：臺灣證券交易所上市與中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃普通股股票；非屬管理股票、興櫃股票及經公告為變更交易方法或停止買賣股票者；但因減資或轉換為控股公司、新設公司或變更面額等原因換發新股票而停止買賣者仍可列入母體。
2. 採樣範圍：指數母體中非屬創黑板之股票，並依 FactSet 的 Revere Business Industry Classification System (RBICS)產業分類，屬附錄一所列 RBICS Level 6 Sub-industry 者¹，且其營業收入占該上市上櫃公司比率超過 50%者。

二、成分股篩選標準：

1. 流動性檢驗：

¹ 所列 RBICS Level 6 Sub-industry 名單每年檢視評估，因應 RBICS 分類的修改或新世代通訊產業的發展而調整。

最近三個月日平均成交金額達 5,000 萬元。

2. 指標篩選：

近四季每股盈餘總和>0。

3. 排序方式：

通過流動性檢驗與指標篩選後，以自由流通市值遞減排序並選取前 30 名之股票。

自由流通市值=自由流通量係數×發行股數×收盤價。

三、權重計算：

1. 自由流通市值加權。

2. 依股票自由流通市值作為計算標準，個別成分股權重不得超過 30%，且前五大成分股權重總和不得超過 65%；其中，若成分股於發行量加權股價指數之權重超過 30%，則以占發行量加權股價指數之權重設為其權重上限。

肆、指數計算方法

一、指數計算頻率：

1. 臺灣科技龍頭通訊指數自 2020 年 10 月 12 日起，於臺灣證券交易所與中華民國證券櫃檯買賣中心交易時間內，每隔五秒以成分股最新成交價格計算及公布即時指數一次，並於每日收盤後計算一次收盤指數。
2. 臺灣指數公司另編製臺灣科技龍頭通訊報酬指數，就臺灣科技龍頭通訊指數考量現金股利因素後加以調整，用以反映包含現金股利之報酬。臺灣科技龍頭通訊報酬指數自 2025 年 7 月 21 日起，於臺灣證券交易所與中華民國證券櫃檯買賣中心交易時間內，每隔五秒以成分股最新成交價格計算及公布即時指數一次，並於每日收盤後計算一次收盤指數。

二、計算公式：

1. 臺灣科技龍頭通訊指數為「價格指數」：

$$\text{指數} = \frac{\text{指數市值}}{\text{指數除數}} \times \text{基準指數}$$

$$Index_t = \frac{\sum_{i=1}^n cp_{i,t} \times s_{i,t} \times p_{i,t}}{Divisor_t} \times 5000$$

$cp_{i,t} \times s_{i,t} \times p_{i,t}$ = 成分股 i 在 t 日的指數成分股市值

n = 指數成分股檔數

$p_{i,t}$ = 成分股 i 在 t 日的價格

$s_{i,t}$ = 成分股 i 在 t 日的發行股數

$cp_{i,t}$ = 成分股 i 在 t 日的係數乘積；使用之係數依本公司「[TIP 指數系列企業活動處理通則](#)」市值投資型指數所定

$Divisor$ = 「價格指數」之指數除數；收盤後成分股依本公司「[TIP 指數系列企業活動處理通則](#)」市值投資型指數調整指數除數以維持指數連續性，調整方式如下：

指數除數 = 前 1 日指數除數

$$\times \left(\frac{\text{前 1 日收盤之指數市值} \pm \text{異動指數市值}}{\text{前 1 日收盤之指數市值}} \right)$$

註 1：基期設定為 2020 年 8 月 14 日，基準指數設定為 5000 點。

註 2：在基期之指數除數即為當時指數市值

$$\sum_{i=1}^n cp_{i,launch} \times s_{i,launch} \times p_{i,launch}, launch = \text{基期}。$$

2. 臺灣科技龍頭通訊報酬指數為「報酬指數」：

$$\text{指數} = \frac{\text{指數市值}}{\text{指數除數}} \times \text{基準指數}$$

$$Index_t = \frac{\sum_{i=1}^n cp_{i,t} \times s_{i,t} \times p_{i,t}}{DivisorTR_t} \times 5000$$

$DivisorTR$ = 「報酬指數」之指數除數；收盤後成分股依本公司「[TIP 指數系列企業活動處理通則](#)」市值投資型指數調整指數除數以維持指數連續性，調整方式如下：

指數除數 = 前 1 日指數除數

$$\times \left(\frac{\text{前 1 日收盤之指數市值} \pm \text{異動指數市值}}{\text{前 1 日收盤之指數市值}} \right)$$

伍、指數成分股調整及指數維護作業

一、成分股定期審核調整：

1. 每年 2 次進行成分股定期審核，以 4 月及 10 月的第 7 個交易日為審核基準日，審核資料截至 3 月及 9 月最後 1 個交易日。每次定期審核後選取固定的成分股檔數 30 檔。
2. 成分股定期審核結果，於審核基準日之後，間隔 5 個交易日後生效。
3. 指數除數維護方式，採成分股定期審核生效日前一交易日收盤資料，計算新成分股組合與原成分股組合之指數市值差異作為異動指數市值。
4. 控股公司或新設公司定期審核使用之成分股篩選資料期間不足者，如轉換股份之代表公司符合採樣母體資格，得合併採用該代表公司或股票之資料。

二、臺灣科技龍頭通訊指數為市值投資型指數，成分股不定期調整、係數乘積、發行股數、指數除數等維護，依本公司「[TIP 指數系列企業活動處理通則](#)」辦理；成分股若因此刪除，則不予遞補。

三、自由流通量係數處理原則：

1. 自由流通量係數若低於 10%，則不納入成分股採樣。
2. 配合成分股定期審核生效日，更新自由流通量係數。
3. 自由流通量係數依據臺灣指數公司「[自由流通量係數編製規則](#)」產製之最近期數據更新。

附錄一、本指數選用之 RBICS Level 6 Sub-industry 名稱

RBICS Level 6 Sub-industry	
Asia Excluding China Wireless Telecom Services	Cable Interconnect Components
Cellular Site Equipment	Colocation and Data Center Services
Electronic Materials Manufacturing	Fixed Microwave Systems Equipment
Flexible Circuit Manufacturing	General Carrier Edge (Access) Equipment
General Communications Equipment	General Metal Parts and Components Makers

Lasers and Optical Instrument Manufacturing	Magnetic Passive Electronic Components
Mixed International Telecommunications Services	Multimedia Semiconductors
Multi-Process Assembly Services	Optoelectronics Electronic Components
Oscillator and Piezoelectric Passive Components	Other Communications Semiconductors
Other Front End Processing Equipment Makers	Other Interconnect Components
Other Interconnect Fabrication Services	Other Passive Capacitor Electronic Components
Other Passive Electronic Components	Other Power Analog and Mixed Signal Semiconductors
Other Specialized Semiconductors	Other Test and Measurement Equipment
Other Wide Area Networking (WAN) Equipment	Power Module and Subassembly Electronic Components
Printed Circuit Board/Wiring Board Manufacturing	Programmable Logic Device Semiconductors
Radio Frequency/Microwave Passive Electronic Parts	RF Analog and Mixed Signal Semiconductors
Security and Identification Semiconductors	Semiconductor Assembly and Packaging Services
Semiconductor Components / Subsystems Manufacturing	Semiconductor Foundry Services
Semiconductor Packaging and Testing Services	Semiconductor Testing Services
Semiconductors Distributors	Smart Phone Manufacturing
Test and Measurement Communications Equipment	Turnkey Assembly Manufacturing Services
Wireless and Wi-Fi Equipment	Wireless Infrastructure Services
Wireline Equipment	General Graphics Accelerator/Controller
A.I./Data Center/Large Scale Processing GPU	Computer/Gaming Graphics Accelerator/Controller
Artificial Intelligence Data Centers	Handheld Graphics Accelerator/Controller
Artificial Intelligence Development Software	Quantum Computing Software